



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENT- UND **MARKENAMT**

Offenlegungsschrift

_® DE 101 44 704 A 1

f) Int. Cl.⁷: H 01 L 21/60

(1) Aktenzeichen:

101 44 704.3

② Anmeldetag:

11. 9.2001

(3) Offenlegungstag:

27. 3.2003

(7) Anmelder:

Infineon Technologies AG, 81669 München, DE

Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler, 82049 Pullach

② Erfinder:

Mergenthaler, Egon, Dipl.-Phys., 91058 Erlangen,

56 Entgegenhaltungen:

DE 44 24 753 A1 US 58 18 700 A ΕP 10 96 533 A1 WO 01 61 753 A1 WO 00 30 141 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Verfahren zum Verbinden eines Bauelements mit einem Träger und Anschlussfläche zur Herstellung einer Verbindung zwischen einem Bauelement und einem Träger
- Bei einem Verfahren zum Verbinden eines Bauelements mit einem Träger, bei dem das Bauelement zumindest einen ersten Anschlussbereich aufweist, und bei dem der Träger zumindest einen zweiten Anschlussbereich aufweist, werden zunächst elektrisch leitfähige, flexible Mikroteilchen (100) auf dem ersten Anschlussbereich und/ oder auf dem zweiten Anschlussbereich erzeugt. Anschließend erfolgt eine Verbindung der Anschlussbereiche über die elektrisch leitfähigen, flexiblen Mikroteilchen.



